

证券代码：688213

证券简称：思特威

思特威（上海）电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-7-2

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华安证券、竹润投资、博时基金、广发证券
时间	2024年7月9日-7月10日
地点	线下交流、线上交流
上市公司接待人 员姓名	孟亚文、李烨陶
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>围绕公司近期的发展情况，公司管理层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面：</p> <p>1、请公司简单介绍下存货管理情况：</p> <p>答：公司存货管理张弛有度。2023年，公司加强存货管理，采取积极措施去化库存，提高存货周转速度，存货余额为22.69亿元，同比下降6.56亿元。2024年第一季度，公司高阶5000万像素产品的预期出货进一步增长，为满足客户需求，公司主动备货该类产品，存货余额增加5.67亿元。</p> <p>2、请简单介绍公司产品的竞争优势：</p> <p>答：公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用看护摄像机、智能门铃、无人机、扫地机器人、工业相机、智慧交通、人脸识别等智慧安防领域；智能化的车载行车记录仪、车载环视及后视摄像头、驾驶员监测系统、乘客监测系统等汽车电子应用领域；智能手机、平板电脑、智能家居、智能健</p>

康等消费电子应用领域，推动着智能生活的发展和进步。

通过 FSI-RS 系列、BSI-RS 系列和 GS 系列的全面布局，以技术为驱动，满足行业应用领域对低照度光线环境下成像优异、高温工作环境下维持芯片高性能、光线对比强烈环境下明暗细节呈现、拍摄快速运动物体无畸变/拖尾、高帧率视频拍摄等刚性需求，具备与索尼等领先的 CMOS 图像传感器厂商竞争的核心优势，深入覆盖高、中、低端各种层次，满足客户多样化的产品需求。

3、请简单介绍公司的研发情况：

答：公司秉承“让人们更好地看到和认知世界”的愿景，坚持“以客户为核心，致力于提供高质量、智能的视频解决方案”的理念，紧贴客户需求开发了一系列有特色的核心技术。深入挖掘智慧安防、智能手机、汽车电子等新兴图像传感器应用领域客户需求，研发出了多样化、差异化的产品系列，覆盖高中低阶的全系列产品，满足不同定位的客户需求。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 424 项（其中境外专利授权 98 项）。

同时，为了巩固既有产品的技术领先性同时研发新技术、新产品，公司高度重视人才的引进和培养，将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源，广纳海内外技术人才，已经建立了一支卓越的研发团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 343 人，研发人员数量占公司总人数的比例为 47.84%，其中 192 名研发人员拥有硕士及以上学历。

4、请简单介绍一下公司未来的战略规划

答：公司自成立以来，一直专注于高性能 CMOS 图像传感器的研发和设计。通过卓越的技术创新和高效的研发能力，积累并构建了成熟的核心技术体系，提供系列化、差异化的产品满足多场景和全性能的市场需求。未来，公司将进一步丰富产品系列和应用领域，加强人才队伍建设，同时不断提升行业领先的研发效率，保持与下游应用和客户的紧密联系，持续改进公司的产品，

	<p>优化和提高产品性能和用户体验，提升客户满意度，以提高市场占有率和品牌影响力，促进公司稳健发展。</p> <p>5、请简单介绍公司的智能手机业务发展情况：</p> <p>答：2023年，公司智能手机业务蓬勃发展，智能手机 CIS 产品覆盖了目前手机市场的主流需求，产品分辨率从 80 万像素到 5000 万像素均已配备，全年实现营收 89,178.76 万元，较上年同期增长 50.40%，占主营收入的比例为 31.21%。</p> <p>针对高端旗舰机产品赛道，公司推出的数颗用于旗舰机主摄、辅摄（包括长焦和广角）的 XS 系列高端产品已经大规模出货，这不仅为公司的营收开辟了第二条增长曲线，更标志着公司在追赶海外龙头厂商的高端产品线方面取得了显著进展，从而进一步提升了公司的市场地位和品牌影响力。</p> <p>6、公司的供应链资源具备怎样的优势：</p> <p>答：在目前的产业格局下，供应链是保障半导体及集成电路设计公司稳定发展的重要环节。公司的产品设计与晶圆厂的生产工艺深度融合优化，满足多应用领域的场景适应性需求。公司将自身的技术优势和供应商的产能以及战略需求进行有效融合，通过技术合作的方式，在达成产品和工艺突破的同时，还增强了供应商粘性。公司采取了多区域供应链布局策略，在多国家和地区均建立战略合作级别的晶圆代工以及封测合作平台，以“多管齐下”的方式，充分且高效地整合供应链资源，为产能提供有力保障。</p>
附件清单（如有）	无